

【1】 試料をパッケージから取り出し、解析のための予備調査を実施

- ・断面構造確認(メタルO層、poly-SiO層)
- ・配線、接続材料確認(AI配線orCu配線等)

FIBを用いた断面構造観察
(メタル5層配線であることを確認)



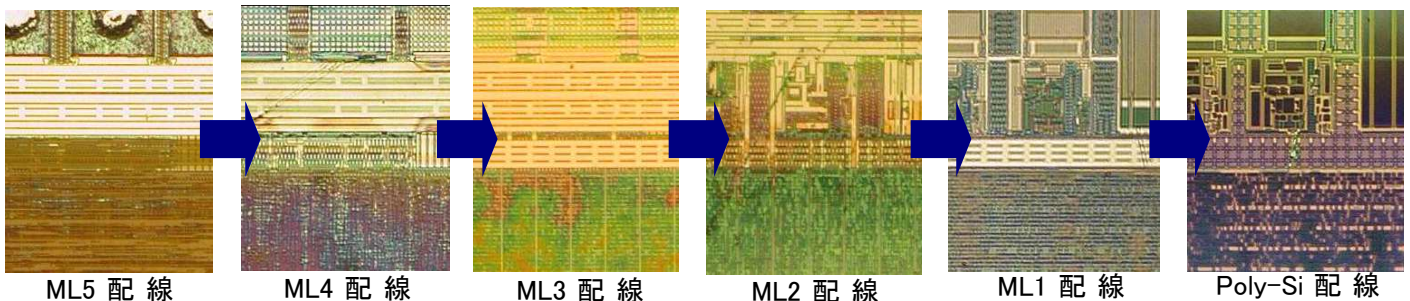
配線層露出のための
研磨方法、研磨材料の選定



組成分析による配線材料特定
(Cu配線であることを確認)

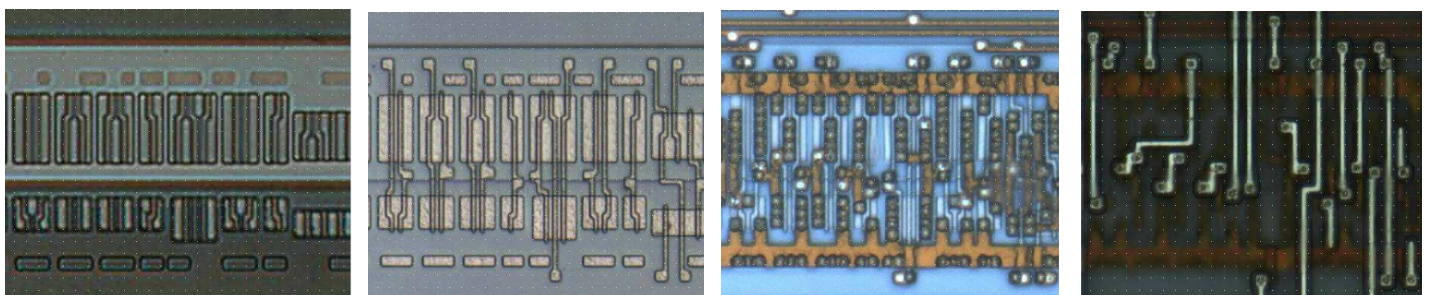
【2】 各配線層の露出

- ・研磨、エッチング等により各層を露出させる



【3】 層間接続を認識

配線パターン、スルーホール痕から接続構造をトレースする。



【3】 回路図作成

トレース結果を基に、回路図化する。

